06

Формирование n-p-переходов на основе p-CdHgTe с низкой концентрацией носителей заряда

© В.В. Васильев, С.А. Дворецкий, Н.Н. Михайлов, Д.Ю. Протасов, Р.Н. Смирнов

Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск E-mail: protasov@thermo.isp.nsc.ru

Поступило в Редакцию 28 марта 2006 г.

Представлены первые результаты по формированию n^+-p -фотодиодов с длинноволновой границей $\lambda_{0.5}=10.6\,\mu\mathrm{m}$ на основе $p\text{-}\mathrm{CdHgTe}$ с концентрацией дырок $3.3\cdot10^{14}\,\mathrm{cm}^{-3}$. Образцы CdHgTe получены методом молекулярнолучевой эпитаксии и после роста имели $p\text{-}\mathrm{Tun}$ проводимости. Концентрация и подвижность носителей заряда определялась методом "спектра подвижности". На выращенных структурах без проведения отжигов методом ионной имплантации B^+ были изготовлены n^+-p -фотодиоды. Оценочное значение произведения $R_0 \times A$ для полученных фотодиодов составляет $20\,\Omega\cdot\mathrm{cm}^2$ при температуре 77 К.

PACS: 81.05.Hd

Ваедение. Современные тепловизионные системы наблюдения в инфракрасном (ИК) диапазоне $3 \div 20\,\mu\mathrm{m}$ широко используют фотодиодные многоэлементные фотоприемные устройства (МФПУ) на основе $\mathrm{Cd}_x\mathrm{Hg}_{1-x}\mathrm{Te}$ (КРТ), где x — мольное содержание теллурида кадмия в твердом растворе.

Пороговые характеристики МФПУ на основе матриц ИК-фотодиодов (ФД) характеризуются произведением $R_0 \times A$, где R_0 и A — сопротивление при нулевом смещении и геометрическая площадь p-n-перехода соответственно. В свою очередь, R_0 определяется темновым током, величина которого зависит от механизмов переноса носителей через p-n-переход [1]. Традиционно для матрицы ФД на основе n^+-p -переходов используют материал КРТ p-типа проводимости, которая обусловлена вакансиями ртути как акцепторными центрами, с концентрацией дырок $10^{15}-10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$ [2]. Считается, что такой интервал концен-

трации дырок оптимален для получения максимальных значений $R_0 \times A$ для резкого n^+-p -перехода, темновой ток через который определяется диффузионной и генерационно-рекомбинационной составляющими тока при обратном смещении.

С точки зрения фундаментальных законов физики полупроводниковых прямозонных материалов для ИК ФД темновой ток в узкозонном материале *p*-типа лимитируется механизмом рекомбинации Оже-7 [2,3]. В этом случае $R_0 \times A$ достигает максимального значения для $p = \gamma^{1/2} n_i$, где n_i — собственная концентрация носителей заряда, $\gamma = \tau_{\rm A7}^i/\tau_{\rm A1}^i$ отношение собственных рекомбинационных времен процессов Оже-7 и Оже-1 [4]. Теоретические значения γ лежат в широком интервале, который по различным данным составляет $3 \div 20$ [3,4]. Расчет с учетом зависимости n_i от ширины запрещенной зоны при 77 K дает величину концентрации дырок $p \approx (5 \div 6) \cdot 10^{13} \, \mathrm{cm}^{-3}$ в материале КРТ для получения максимальной величины $R_0 \times A$ для $\Phi \square$ с длиной волны отсечки $10.6\,\mu\mathrm{m}$ ($X_{\mathrm{CdTe}}=0.226$) на основе n^+-p -перехода. На практике получение такого уровня концентрации дырок и управление им затруднено. Также возникают проблемы при характеризации параметров материала КРТ р-типа проводимости с низкой концентрацией носителей менее $10^{15}\,\mathrm{cm}^{-3}$. Это связано с практически равным вкладом в проводимость дырок и электронов, подвижности которых отличаются на 2 порядка.

В настоящей работе приведены параметры p-n-переходов, полученных имплантацией бора в гетероэпитаксиальные слои (ГЭС) КРТ p-типа проводимости, выращенные методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) с низкой концентрацией дырок. Концентрация и подвижность носителей определялись из анализа магнитополевых зависимостей коэффициента Холла и проводимости. Время жизни неосновных носителей (электронов) определялось по релаксации фотопроводимости методом СВЧ [5].

Экспериментальная часть. ГЭС КРТ МЛЭ были выращены на установке "Обь-М", детальное описание процессов роста дано в работах [6,7]. В качестве подложек использовались пластины (013)GaAs диаметром два дюйма, на которых последовательно выращивались буферные слои ZnTe и CdTe толщиной < 0.1 и $6.3\,\mu$ m соответственно. Распределение состава КРТ по толщине приведено на рис. 1. Рост КРТ начинается с состава $X_{\rm CdTe} = 0.43$, который затем плавно изменяется до $X_{\rm CdTe} = 0.226$ на толщине $1.5\,\mu$ m. Процесс роста слоя КРТ постоянного

^{4*} Письма в ЖТФ, 2006, том 32, вып. 18

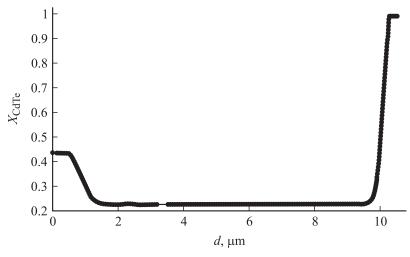


Рис. 1. Распределения состава по толщине (d) слоя КРТ для образца № 2 по измерениям автоматическим эллипсометром in situ.

состава толщиной $\sim 8\,\mu\mathrm{m}$ завершается выращиванием широкозонного слоя с изменением состава до $X_{\mathrm{CdTe}}=0.4$ для образца № 1 и до практически чистого CdTe толщиной $0.24\,\mu\mathrm{m}$ для образца № 2.

Непосредственно после роста были проведены измерения магнитополевых зависимостей эффекта Холла и магнитосопротивления при температуре 77 К в диапазоне магнитных полей $0 \div 2$ Т. Время жизни неравновесных носителей измерялось также при 77 К. Параметры выращенных ГЭС КРТ МЛЭ приведены в таблице.

Параметры исследуемых образцов

Nº	Покрытие поверхности	Состав рабочего слоя $X_{\rm CdTe}$	Толщина ГЭС КРТ, μm	Толщина рабочего слоя,	Время жизни неосновных носителей заряда, μ s
1	Нет	0.229	10.6	7.95	3.36
2	CdTe	0.226	10.53	8.27	0.082

Письма в ЖТФ, 2006, том 32, вып. 18

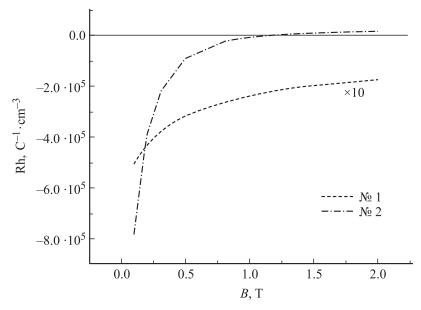


Рис. 2. Магнитополевые зависимости коэффициента Холла и магнитосопротивления при 77 K.

На рис. 2 представлены магнитополевые зависимости эффекта Холла. Для образца № 1 величина коэффициента Холла увеличена в 10 раз.

Как видно из рис. 2, знак коэффициента Холла R_h для образца № 1 отрицателен во всем диапазоне магнитых полей. Значение коэффициента Холла незначительно возрастает с увеличением магнитного поля: от $-5.1 \cdot 10^4 \, \mathrm{C^{-1} \cdot cm^{-1}}$ при B = 0.1 до $-1.7 \cdot 10^4 \, \mathrm{C^{-1} \cdot cm^{-1}}$ при $B = 2 \, \mathrm{T}$. Такая зависимость типична для образцов n-типа с концентрацией электронов $10^{14} \, \mathrm{cm^{-3}}$. Однако для образца № 2 R_h возрастает гораздо сильнее (от $-7.8 \cdot 10^5 \, \mathrm{C^{-1} \cdot cm^{-1}}$ при $B = 0.1 \, \mathrm{T}$ до $1.59 \cdot 10^4$ при $B = 2 \, \mathrm{T}$) и становится положительным при $B = 1.15 \, \mathrm{T}$. Эт свидетельствует о дырочном характере проводимости образца. Знак коэффициента Холла в диапазоне магнитных полей $0 \div 1.15 \, \mathrm{T}$ отрицателен, так как вклад в эффект Холла носителей разных типов пропорционален $\mu^2 n/(1 + \mu^2 B^2)$, и в области малых магнитных полей знак эффекта определяется

электронами вследствие большой разницы между подвижностями электронов и дырок. Поэтому измерение эффекта Холла при фиксированном значении магнитного поля из этого диапазона может привести к неверному заключению, что образец $N_{\rm e}$ 2 является "плохим" n-типом с низкой концентрацией ($\sim 10^{13}~{\rm cm}^{-3}$) и невысокой подвижностью.

Применяя метод "спектра подвижности" [8] в сочетании с многозонной подгонкой [9], для образца № 2 были получены следующие значения подвижности и концентрации дырок и электронов: $\mu_{p1} = 280 \, \mathrm{cm^2/V \cdot s}, \quad p1 = 3.3 \cdot 10^{14} \, \mathrm{cm^{-3}}, \quad \mu_{p2} = 30\,000 \, \mathrm{cm^2/V \cdot s}, \quad p2 = 3.4 \cdot 10^{11} \, \mathrm{cm^{-3}}, \quad \mu_{n1} = 230\,000 \, \mathrm{cm^2/V \cdot s}, \quad n1 = 1.2 \cdot 10^{11} \, \mathrm{cm^{-3}}, \quad \mu_{n2} = 70\,000 \, \mathrm{cm^2/V \cdot s}, \quad n2 = 5.0 \cdot 10^{11} \, \mathrm{m^{-3}}.$ Как видно из приведенных результатов, в образце присутствуют два типа электронов: "медленные" и "быстрые". Для выяснения их природы необходимы дальнейшие исследования.

Характеристики диодов. На образце № 2 без дополнительных термообработок были изготовлены p-n-переходы методом ионного легирования. В качестве легирующей примеси использовались ионы B^+ с энергией 50 keV и дозой $3 \cdot 10^{13}$ cm $^{-2}$. Размеры окна в фоторезисте для легирования — $10 \times 10 \, \mu$ m. На рис. 3 приведены вольт-амперные характеристики и динамическое сопротивление полученных диодов.

Хорошо видно, что диоды характеризуются постоянной величиной динамического сопротивления при обратном смещении до $0.4\,\mathrm{V}$, свидетельствующей о высоком качестве n-p-перехода. Величина темнового тока высокая, а динамическое сопротивление мало, что объясняется большими геометрическими размерами полученного n-p-перехода и большой площадью сбора неосновных носителй заряда вследствие высокого значения диффузионной длины.

Геометрические размеры n-p-перехода при ионной имплантации в КРТ формируются диффузией ртути из области, содержащей радиационные дефекты. В литературе по ионной имплантации [10,11] отсутствуют данные о длине диффузии ртути в образцах с концентрацией дырок порядка $10^{14}\,\mathrm{cm}^{-3}$, однако показано, что с уменьшением концентрации дырок коэффициент диффузии ртути возрастает. Такую диффузию можно рассматривать как диффузию из ограниченного источника с мощностью

$$Q_0 = \oint_V N(x, y, z) dV, \tag{1}$$

где N(x, t, z) — распределение концентрации атомов ртути.

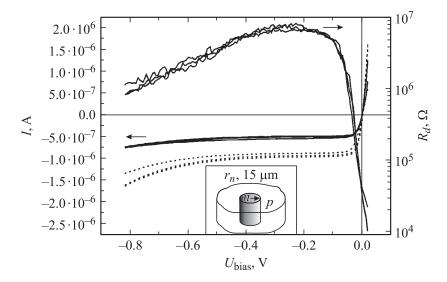


Рис. 3. Вольт-амперные характеристики диодов и динамическое сопротивление диодов. Левая шкала — вольт-амперные характеристики диодов. Сплошные линии — без фоновой засветки, пунктирные — засветка фоном с температурой 293 К и апертурой $2\Theta=18^\circ$. Правая шкала — динамическое сопротивление диодов без фоновой засветки.

Так как часть междоузельной ртути рекомбинирует с вакансиями ртути, то можно записать

$$N(x, y, z) = -p_0 + n(x, y, z), \tag{2}$$

где n(x, y, z) — распределение концентрации электронов в n^- -слое.

Для оценки размеров p-n-перехода предположим, что $n(x,y,z)=n_0=$ const, которая зависит только от параметров легирования. Тогда мощность диффузионного источника запишется в виде

$$Q_0 = (n_0 - p_0)V. (3)$$

Следовательно, для двух образцов с разной концентрацией дырок p_1 и p_2 при одинаковых режимах имплантации

$$p_1 V_1 = p_2 V_2, (4)$$

где p_1 , p_2 — концентрации дырок, V_1 , V_2 — объемы n^- -слоев получившихся n-p-переходов. Нами экспериментально определено, что для выше приведенных параметров имплантации в образцах с концентрацией дырок $\sim 5 \cdot 10^{15} \, \mathrm{cm}^{-3}$ переход находится на глубине $1.5 \div 2\,\mu\mathrm{m}$, n^+ имеет толщину $\sim 0.5\,\mu\mathrm{m}$. Тогда при радиусе окна легирования $5\,\mu\mathrm{m}$ объем n^- -слоя составит $\sim 70\,\mu\mathrm{m}^3$. Для образца с концентрацией $3.3 \cdot 10^{14} \, \mathrm{cm}^{-3}$ из соотношения (4) получим объем n^- -слоя $\sim 1000\,\mu\mathrm{m}^3$, а радиус перехода будет порядка $15\,\mu\mathrm{m}$, причем n^- -слой распространится на всю толщину пленки. Схематически структура получившегося цилиндрического n-p-перехода представлена на вставке рис. 3.

Учесть боковой сбор неосновных носителей в цилиндрическом диоде можно с помощью коэффициента [12]:

$$f_{3D} = 2\left(\frac{R}{L}\right)^{-1} \frac{K_1\left(\frac{R}{L}\right)}{K_0\left(\frac{R}{L}\right)},\tag{5}$$

где R — радиус перехода, L — длина диффузии, $K_0(x)$, $K_1(x)$ — функции Ганкеля. Длину диффузии L находим по формуле $L=\sqrt{D\tau}$, используя измеренные значения подвижности электронов и их времени жизни: $\mu_n=230000\,\mathrm{cm^2/V\cdot s},\, \tau_n=82\,\mathrm{ns}.$ Для данного образца длина диффузии составит $112\,\mu\mathrm{m}$, соответственно коэффициент f_{3D} равен 51.7. Тогда произведение R_0A для данного диода будет равным 19.5, что совпадает с лучшими опубликованными значениями R_0A [1] для длины волны отсечки $\lambda_c=10.6\,\mu\mathrm{m}$.

Заключение. Продемонстрирована возможность получения материала p-типа с низкой концентрацией дырок (порядка $10^{14}\,\mathrm{cm^{-3}}$). На полученных образцах по стандартной технологии изготовлены тестовые фотодиоды. Показано, что наблюдается увеличение R_0A в 2-3 раза по сравнению с типичными диодами, изготовленными из материала с концентрацией дырок $10^{16}\,\mathrm{cm^{-3}}$. Возможно дальнейшее увеличение R_0A и уменьшение темновых токов фотодиодов при оптимизации технологии изготовления n^+-p -переходов на образцах с низкой концентрацией дырок.

Авторы благодарят В.С. Варавина за измерение времени жизни и Т.И. Захарьяш за изготовление диодов.

Список литературы

- [1] Рогальский А. Инфракрасные детекторы. Новосибирск: Наука, 2003. 636 с.
- [2] Rogalsky A. // Infrared Phys. 1988. V. 28. N 3. P. 139-153.
- [3] Kinch M.A. // J. Electron. Mater. 2000. V. 29. N 6. P. 809-817.
- [4] *Piotrowski J.* // Infrared Photon Detectors / Ed. by A. Pogalski. SPIE Optocal Engineering Press. Bellingham, 1995. P. 391–493.
- [5] Бородовский П.А., Булдыгин А.Ф. // Автометрия. 1997. № 4. С. 59–72.
- [6] Сидоров Ю.Г., Дворецкий С.А., Михайлов Н.Н. и др. // Оптический журнал. 2000. Т. 67. № 1. С. 39–45.
- [7] Сидоров Ю.Г., Дворецкий С.А., Михайлов Н.Н. и др. // ФТП. 2001. Т. 35. В. 9. С. 1092—1101.
- [8] Beck W.A., Anderson J.R. // J. Appl. Phys. 1987. V. 62. N 2. P. 541-554.
- [9] Meyer J.R., Hoffman C.A., Bartoli F.J. et al. // Sem. Sci. Technol. 1993. V. 5. P. 805–823.
- [10] Destefanis G.L. // J. Cryst. Growth. 1988. V. 86. P. 700-722.
- [11] Bubulac L.O. // J. Cryst. Growth. 1988. V. 86. P. 723–734.
- [12] Grimbergen C.A. // Solid-State Electron. 1976. V. 19. P. 1033–1037.